

平成21年3月期 決算短信

平成21年4月28日

上場取引所 東

上場会社名 新光電気工業株式会社
 コード番号 6967 URL <http://www.shinko.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 黒岩 護
 問合せ先責任者 (役職名) 経営企画室長 (氏名) 清野 貴博
 定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日
 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月30日

TEL 026-283-1000
 平成21年6月29日
 配当支払開始予定日

(百万円未満切捨て)

1. 21年3月期の連結業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期	140,510	△34.6	△6,823	—	△6,961	—	△6,042	—
20年3月期	215,007	4.4	25,126	△28.9	21,050	△39.7	11,336	△41.0

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
21年3月期	△44.73	—	△4.4	△3.9	△4.9
20年3月期	83.92	—	8.1	10.6	11.7

(参考) 持分法投資損益 21年3月期 一百万円 20年3月期 一百万円

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
21年3月期	156,266	132,959	85.1	984.22
20年3月期	198,475	143,193	72.1	1,059.98

(参考) 自己資本 21年3月期 132,959百万円 20年3月期 143,193百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
21年3月期	33,526	△20,348	△3,611	50,776
20年3月期	37,644	△24,259	△3,622	41,885

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					配当金総額 (年間)	配当性向 (連結)	純資産配当 率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
20年3月期	—	9.00	—	18.00	27.00	3,647	32.2	2.6
21年3月期	—	4.00	—	4.00	8.00	1,080	—	0.8
22年3月期 (予想)	—	4.00	—	4.00	8.00		—	

3. 22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期 連結累計期間	55,300	△41.8	△2,900	—	△2,800	—	△2,000	—	△14.80
通期	123,600	△12.0	△3,700	—	△3,500	—	△2,700	—	△19.99

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無
新規 一社 (社名) 除外 一社 (社名)

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

(注)詳細は、16 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 21年3月期 135,171,942株 20年3月期 135,171,942株
② 期末自己株式数 21年3月期 81,252株 20年3月期 80,852株

(注)1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、28 ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

(参考)個別業績の概要

1. 21年3月期の個別業績(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21年3月期	136,336	△34.9	△7,177	—	△6,850	—	△5,782	—
20年3月期	209,582	4.7	24,047	△29.2	20,357	△39.4	11,933	△35.9

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
21年3月期	△42.81	—
20年3月期	88.33	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	%	円 銭		
21年3月期	155,703		132,894		85.4	983.74		
20年3月期	196,303		141,674		72.2	1,048.73		

(参考) 自己資本 21年3月期 132,894百万円 20年3月期 141,674百万円

2. 22年3月期の個別業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期 累計期間	53,600	△41.9	△2,800	—	△2,600	—	△1,900	—	△14.06
通期	120,000	△12.0	△3,700	—	△3,500	—	△2,700	—	△19.99

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。
実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
なお、業績予想に関する事項は、3 ページ「経営成績 1. 経営成績に関する分析」をご参照ください。

経営成績

1. 経営成績に関する分析

<当期の概況>

当期の経済環境は、サブプライムローン問題を発端とする世界的な金融危機が実体経済への悪影響を急速に拡大させ、日本におきましては、輸出の急減や大幅な生産調整等により企業収益悪化が深刻化し、設備投資および個人消費が減速するなど、厳しい景気後退局面となりました。海外におきましては、米国では雇用情勢の悪化や株式市場の低迷が続く、消費マインドの冷え込みによる需要減退が企業の売上不振・雇用調整を加速させ、さらなる消費停滞へとつながる悪循環に陥り、アジア地域においてもグローバルな需要の縮小により輸出が急落するなど、経済成長の大幅な減速を余儀なくされました。

半導体業界につきましては、世界的な景気の落ち込みを背景として、パソコンや携帯電話、デジタル家電等の主要用途向け市場において、期後半にかけて過去に例を見ないほどの規模とスピードで在庫調整圧力が高まり、ほぼ全面的に需要が激減する極めて深刻な市場環境に陥りました。

このような状況下にあつて、当社グループにおきましても、半導体需要減少に伴う急激な在庫調整の影響を大きく受け、当期の連結売上高は、1,405億10百万円（対前期比34.6%減）となりました。収益面につきましては、大幅な受注環境悪化に対処すべく、全社において一段の経費削減および投資圧縮等の緊急対策を実行するとともに、生産革新活動の推進による在庫縮減・生産性向上に注力いたしましたが、急激な減産に加えて、製品単価低下の継続、さらには為替相場のドル安・円高の影響を受けたことなどから、連結ベースの経常損失は69億61百万円、当期純損失は60億42百万円と極めて厳しい結果となりました。

部門別の状況は次のとおりであります。

(1) ICリードフレーム部門

半導体市況悪化の影響を受け、プレスリードフレームおよびエッチングリードフレームの受注が減少したほか、LOCタイプリードフレームについても、メモリー市場の低迷により需要が減退いたしました。この結果、当部門の連結売上高は208億79百万円（対前期比26.5%減）となりました。

(2) ICパッケージ部門

フリップチップタイプパッケージは、パソコン市場の減速および在庫調整の影響を受け、また、アセンブリ事業においては、携帯電話やデジタルカメラ向け等の需要が急減し、それぞれ受注が大幅に減少いたしました。DRAM向けのBOCタイプBGA基板は、需要低迷に加えて製品価格が低下し、MPU向けのヒートスプレッダーについては、期前半は好調に推移したものの、期後半の急激な調整により、いずれも売上が減少いたしました。この結果、当部門の連結売上高は1,065億49百万円（対前期比35.7%減）となりました。

(3) 気密部品部門

セラミック静電チャックは、半導体製造装置市場の低迷が続く大幅な受注減少となりました。

また、光素子用ガラス端子および携帯電話向けの精密接触部品についても、需要後退と在庫調整の影響により売上が減少いたしました。この結果、当部門の連結売上高は130億77百万円（対前期比37.3%減）となりました。

当社の単独決算につきましては、受注高は1,312億86百万円（対前期比37.2%減）、売上高は1,363億36百万円（同34.9%減）となりました。また、経常損失は68億50百万円、当期純損失は57億82百万円を計上いたしました。

<次期の見通し>

今後の経済環境は、日本におきましては、世界経済の落ち込みを背景として輸出の低迷が続き、製造業を中心として生産調整局面の継続および投資抑制基調の長期化が予測されるほか、所得環境の悪化に伴う消費不振が一層進むなど、景況感是一段と厳しさを増すことが想定されます。また、米国経済につきましては、金融・経済対策の進展による景気の底入れが期待されるものの、雇用環境悪化による個人消費低迷の長期化も見込まれるなど、依然として先行き不透明な状況が継続するものと思われまます。

半導体業界におきましても、電気・電子機器、自動車等をはじめとする半導体製品の最終需要の不振がさらに継続することが想定される一方で、供給能力の過剰等を背景に稼働率は依然として低水準に留まり、本格的な回復にはなお相当の時間を要することが見込まれます。また、企業間競争の一層の激化と低コスト製品への需要シフト等により、製品価格の低下圧力が一層強まることも予測されるなど、市況低迷の長期化が強く懸念される厳しい状況が続くものと予想されます。

このような厳しい状況に対処するため、当社グループといたしましては、全社において緊急対策を継続・徹底し、経営資源の最適化に努め、収益性の改善をはかるとともに、半導体パッケージのリーディングカンパニーとして、創業以来蓄積してきた半導体実装の要素技術をさらに深化・発展させることにより、お客様のニーズに即した新製品の市場投入に注力してまいります。また、熾烈な競争が繰り返される半導体市場にあつて、現下の厳しい環境を乗り越え、「限りなき発展」を果たすべく、徹底した現場主義に基づく生産革新活動の推進に一段と拍車をかけ、高品質の製品を作りこむ卓越した「ものづくり」の製造現場を構築し、全社一丸となって収益構造の再構築に努めてまいります。

次期の業績予想につきましては、以上の諸対策を実行するものの、極めて厳しい環境が継続し、また、前連結会計年度に比較して為替が円高傾向で推移することが想定されることなどをふまえ、連結売上高1,236億円（対前期比12.0%減）、連結経常損失35億円、連結当期純損失27億円を見込んでおります。

また、当社単独ベースでは売上高1,200億円（対前期比12.0%減）、経常損失35億円、当期純損失27億円を見込んでおります。

2. 財政状態に関する分析

(1) 資産、負債および純資産の状況

当連結会計年度末における財政状態につきましては、前連結会計年度末に比べ総資産が422億9百万円減少し、1,562億66百万円となりました。負債は319億75百万円減少し、233億6百万円

となりました。純資産は102億34百万円減少し、1,329億59百万円となりました。この結果、自己資本比率は85.1%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は335億26百万円（前年度比41億18百万円減）となりました。また、投資活動の結果使用した資金は203億48百万円（同39億10百万円減）となりました。財務活動の結果使用した資金は36億11百万円（同10百万円減）となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物が前連結会計年度末に比べ88億91百万円増加し、507億76百万円となりました。

3. 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の最重要施策の一つと考えており、半導体業界の急速な技術革新に対応した設備投資や研究開発投資を通じた強固な企業基盤の確立と将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実も考慮し、財政状態、利益水準および配当性向などを総合的に勘案した利益配当を行うことを基本方針としております。

当期における配当につきましては、上記の方針に基づき、厳しい損益状況ではありますが、期末配当を4円とし、中間配当の4円とあわせて年間8円とさせていただく予定であります。

また、次期における配当につきましては、1株当たり年間8円とさせていただく予定であります。

4. 事業等のリスク

当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、以下のようなものがあります。当社グループの事業、業績および財務状況は、かかるリスク要因のいずれによっても下落する可能性があります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで発生の回避および発生した場合の対応に努めております。

(1) 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動

- ①当社グループは、ワールドワイドに事業を展開しており、製品を販売している国または地域の経済状況の影響を受けるとともに、半導体市況等の影響を大きく受ける状況にあります。半導体業界は、急速な技術革新に伴い、高集積化、高速化等の進展が著しく、これに伴って製品のライフサイクルが短くなる傾向にあります。また、売上および収益とも市況環境の変化に伴う価格変動の影響を受ける可能性があります。
- ②競合他社が、低廉な人件費、安価で高品質な部品・原材料の調達、あるいは画期的な製造技術の開発等によって、当社グループと同種の製品をより低価格で製造し供給することになった場合、売上の減少、製品価格の下落等によって、当社グループの業績を低下させる可能性が生じます。
- ③為替相場の変動は、当社グループの経営成績および財政状態、また、競争力にも影響し、当社グループの業績に影響を与えます。為替変動は、主に外貨建てで当社が販売する製品の価格設定に影響します。当社グループは、日本国内を主に製造活動を行っており、輸出による売上がかなりの割合を占めているため、当社グループの業績は、円が他の通貨、とりわけ米ドルに対

して円高になると悪影響を受ける可能性があります。

(2) 特定の取引先・製品・技術等への依存

- ①当社グループ製品の販売先において、一部取引先への納入割合が高くなっており、当該取引先が、事業上または技術上の重大な問題など、何らかの理由により当社グループとの取引額を削減しなければならなくなった場合、当社グループの事業、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。
- ②当社グループは、多数の外部の取引先から原材料および部品を購入していますが、製品の製造において使用するいくつかの原材料等については、一部の取引先に依存しています。効率的に、かつ安いコストで供給を受け続けられるかどうかは、当社グループがコントロールできないものも含めて、多くの要因に影響を受けます。当社グループの購入する原材料等には、貴金属・地金相場等の変動や、取引先からの供給遅延・中断や、原材料等の需給状況・市況環境などによっては、生産に必要な原材料等の調達不足が生じたり、製品コストの上昇要因となる場合があります。これらの原因等により、当社グループの事業、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。

(3) 特有の法的規制・取引慣行、重要な訴訟事件等の発生

- ①当社グループは、ワールドワイドに事業を展開しており、各国における事業・投資の許可、国家安全保障または輸出制限、関税をはじめとするその他の輸出入規制等の政府規制の適用を受けます。また、通商、独占禁止、特許、租税、為替管理規制、環境・リサイクル関連の法的規制等の適用も受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性があります、その結果、当社グループの事業成長および業績が悪影響を受ける可能性があります。
- ②当社グループが独自に開発した技術について、特許権その他の知的財産権を取得することは競争上の優位性をもたらす一方で、その優位性の維持は保証されるわけではなく、技術の変化によっては、その価値を失う可能性があります。また、このような知的財産権等が広範囲にわたって保護できない場合や、広範囲にわたり当社グループの知的財産権等が違法に侵害されることによって訴訟等が生じた場合、多額の費用および経営資源が費やされる可能性があります。

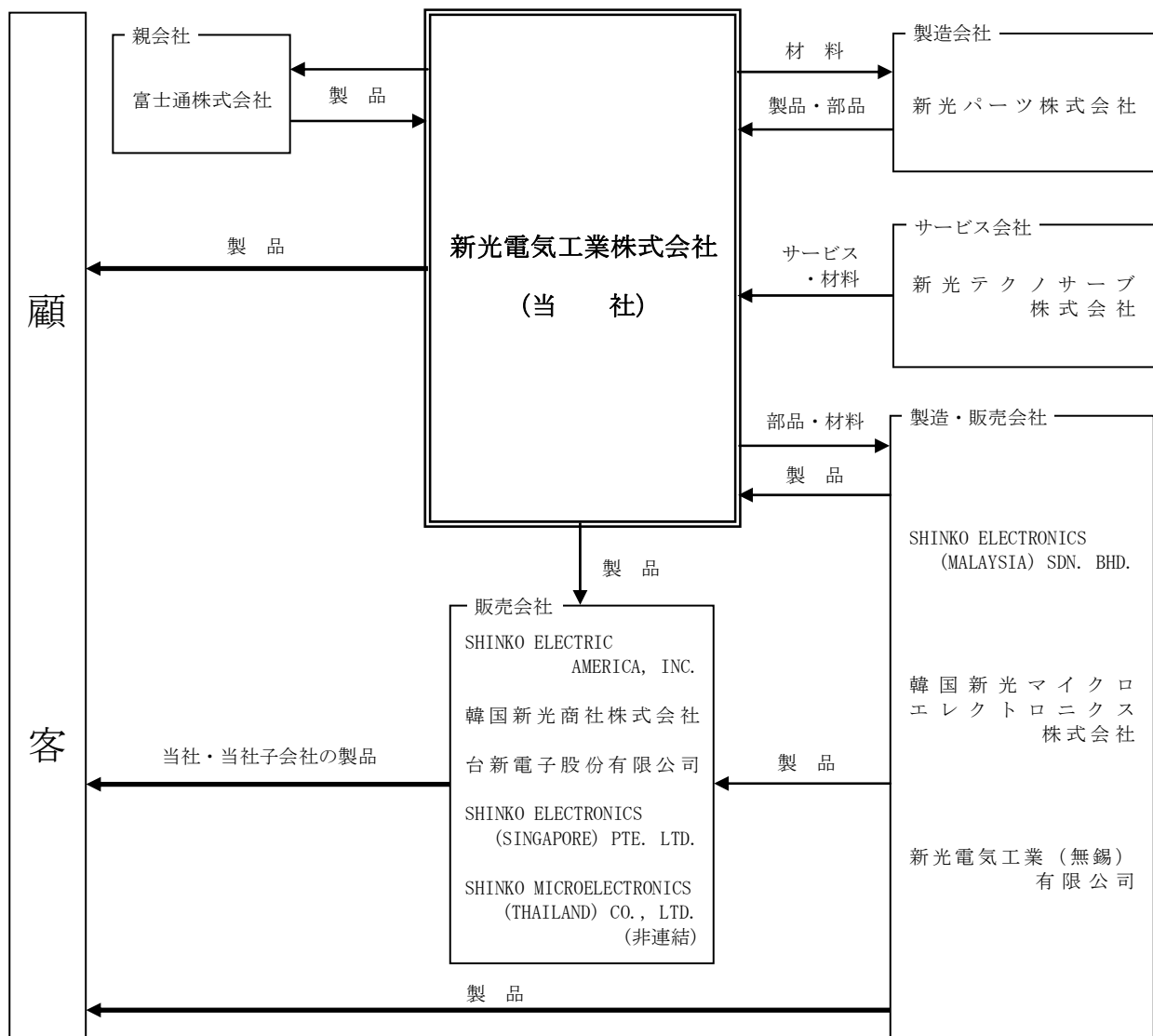
(4) その他

地震等の自然災害によって、原材料や部品の購入、生産、製品の販売、物流やサービスの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起これば、それが長期間にわたる場合、当社グループの事業、財政状態および経営成績に悪影響を与える可能性があります。

企業集団の状況

当社グループは、当社および子会社 10 社（うち連結子会社 9 社）より構成されております。当社の親会社である富士通株式会社は、富士通グループ各社とともに、IT分野において、最先端かつ高性能、高品質を備えた強いテクノロジーをベースとした各種サービスを提供するとともに、これらを支える品質の高いプロダクト、電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供するトータルソリューションビジネスを営んでおり、ソフトウェア・サービス、情報処理および通信分野の製品の開発、製造、販売およびサービスの提供を行っております。また、当社グループは着実な進歩を続けるエレクトロニクス産業にあつて、半導体パッケージのリーディングカンパニーとしてリードフレーム、PLP（プラスチック・ラミネート・パッケージ）、ガラス端子等の幅広い半導体実装技術に基づく製品の開発、製造、販売を主な事業内容としております。

(事業系統図)



経営方針

1. 経営の基本方針

当社は、グローバルな競争が繰り広げられるエレクトロニクス産業にあって、新たなテクノロジーの開発とその蓄積を原動力として、事業環境の変化に即応できる強靱な「ものづくり」を実現し、高い競争力を持つ優れた製品を開発・製造・販売することによって、限りなき発展を目指しています。また、このような「技術力」、「発展性」とともに、「国際性」、「暖かさ」を企業理念として掲げ、世界各国のお客様と取引を行い、各地に拠点を展開するグローバル企業として国際社会での共存共栄を念頭に置き、常に「人と地球環境への暖かさ」を考えた経営姿勢で事業を推進しております。

2. 中長期的な経営戦略

半導体産業は、昨年後半以降の世界的な景気悪化に伴い、急激な市場縮小を余儀なくされましたが、中長期的には、パソコンや携帯機器の高機能化、新興諸国を牽引役とする市場の拡大、さらには自動車のエレクトロニクス化の進展をはじめとした用途の拡大などにより、成長の持続が見込まれます。一方、急速に進化する高集積化・高速化等の技術革新により、製品の世代交代が従来以上に加速するとともに、絶えず変化する市場のニーズに低コストかつ柔軟に対応し得る開発・生産体制を構築することを要するなど、生き残りをかけた世界規模での競争がさらに一段と激化することが予想されます。

このような産業にあって、当社グループは、キャッシュ・フローを重視し、常に利益を創出できる強固な経営基盤の確立に努め、かつコーポレート・ガバナンスの充実をはかるとともに、以下の項目に重点をおいた経営戦略を展開してまいります。

(1) 徹底した現場主義に基づく「ものづくり」の革新

お客様の望まれる品質・納期に対応し、適正な価格でご提供するという製造業の原点に立ち、徹底した現場主義をもって製品の開発、設計から生産、出荷にいたる「ものづくり」のすべての段階において革新し続けることによって、競争力の向上に努め、収益を確保してまいります。

(2) 変化に即応できる企業体質の構築

市場環境の変化が激しく、熾烈な競争が繰り返される半導体産業にあって、変化に即応できる企業体質の構築こそが企業存続・発展の条件ととらえ、全部門において一層の合理化・生産性の向上に努めるとともに、会社創業以来培ってまいりました技術力をもとに、お客様のニーズに速やかに対応し、明確に差別化された製品の開発・量産化を進め、企業体質の強化をはかってまいります。

(3) 周辺環境との調和

市場において必要とされる企業であることはもとより、株主の皆様のご期待に応え、お取引先や従業員、地域社会など企業を取り巻く方々との関係を重視し、また、地球環境と企業活動の調和を基本理念として、社会において必要とされる企業であり続けるべく事業を展開してまいります。

連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	20,754	17,000
受取手形及び売掛金	66,252	22,812
有価証券	1,122	3,173
たな卸資産	8,414	—
商品及び製品	—	551
仕掛品	—	2,396
原材料及び貯蔵品	—	1,066
預け金	20,940	31,430
繰延税金資産	2,167	1,744
その他	1,734	3,747
貸倒引当金	△16	△845
流動資産合計	121,369	83,077
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	20,477	19,225
機械装置及び運搬具（純額）	35,242	26,627
工具、器具及び備品（純額）	4,062	3,129
土地	6,418	6,464
建設仮勘定	5,330	8,335
有形固定資産合計	71,530	63,782
無形固定資産		
1,547	1,547	1,250
投資その他の資産		
投資有価証券	357	310
繰延税金資産	1,957	6,051
その他	1,735	1,815
貸倒引当金	△21	△21
投資その他の資産合計	4,027	8,155
固定資産合計	77,106	73,188
資産合計	198,475	156,266

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成20年3月31日)	当連結会計年度 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	33,281	8,066
短期借入金	1,000	600
未払金	6,581	4,570
未払法人税等	1,045	19
未払費用	8,241	5,257
その他	808	485
流動負債合計	50,958	18,999
固定負債		
退職給付引当金	3,750	3,795
その他	573	511
固定負債合計	4,323	4,307
負債合計	55,282	23,306
純資産の部		
株主資本		
資本金	24,223	24,223
資本剰余金	24,129	24,129
利益剰余金	96,455	87,441
自己株式	△91	△91
株主資本合計	144,716	135,702
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	150	124
為替換算調整勘定	△1,673	△2,867
評価・換算差額等合計	△1,523	△2,742
純資産合計	143,193	132,959
負債純資産合計	198,475	156,266

